

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 8 月 11 日(11.08.2016)

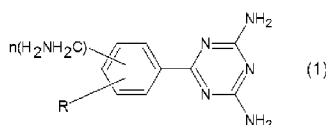


(10) 国際公開番号
WO 2016/125657 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 61/14 (2006.01) *C08K 5/3477* (2006.01)
C08G 8/28 (2006.01) *C08L 61/34* (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01) *H05K 1/03* (2006.01)
C08K 5/3415 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2016/052349
- (22) 国際出願日: 2016 年 1 月 27 日(27.01.2016)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-019302 2015 年 2 月 3 日(03.02.2015) JP
- (71) 出願人: 三菱瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小林 宇志(KOBAYASHI, Takashi); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 高野 健太郎(TAKANO, Kentaro); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 平松 宗太郎(HIRAMATSU, Sotaro); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 稲葉 良幸, 外(INABA, Yoshiyuki et al.); 〒1066123 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 23 階 TMI 総合法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: RESIN COMPOSITION, PREPREG, METAL-FOIL-CLAD LAMINATE, RESIN COMPOSITE SHEET, AND PRINTED WIRING BOARD

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、プリプレグ、金属箔張積層板、樹脂複合シート、及びプリント配線板



(57) Abstract: A resin composition for printed wiring boards which comprises a cyanic acid ester compound (A), a maleimide compound (B), and a benzoguanamine compound (C) having one or two aminomethyl groups and represented by the following general formula (1). [Chemical formula 1] (In general formula (1), R is a hydrogen atom or a substituent selected from the group consisting of C₁₋₁₀ hydrocarbon groups, C₁₋₁₀ alkoxy groups, C₆₋₁₀ aryloxy groups, a hydroxyl group, an amide group, and halogen atoms, and n is an integer of 1-2.)

(57) 要約: シアン酸エステル化合物 (A)、マレイミド化合物 (B)、及び下記一般式 (1) で表されるアミノメチル基を有するベンゾグアナミン化合物 (C) を含有する、プリント配線板用樹脂組成物。(上記一般式 (1) 中、R は、水素原子、又は、炭素数 1~10 の炭化水素基、炭素数 1~10 のアルコキシ基、炭素数 6~10 のアリアルオキシ基、ヒドロキシ基、アミド基、及びハロゲン原子からなる群より選択される置換基であり、n は 1~2 の整数である。)



WO 2016/125657 A1